一、处置

1. 牙非手术治疗（内容不变）
   1. 药物治疗
   2. 再矿化治疗
   3. 窝沟封闭
2. 后牙复合树脂修复（内容不变）
   1. 牙树脂直接充填修复

修改项如下（其它内容参考原有需求）：

1. **去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典）

2. **成形片\***（未使用成形片/ Palodent豆瓣/V3/其他），**楔子\***（未使用楔子/木楔/ Palodent V3/其他）。

* 1. 牙安抚治疗&树脂充填修复

1. 龋病微创修复
   1. ART修复

1. **牙位**，**是否使用显微镜\***（否/显微镜下），**去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典/其它），**制备洞形位置\***（多选项，以英文逗号隔开，唇面/颊面/腭面/近中面/远中面/合面/根面），**制备洞形深度\***（输入项，单位为mm）。

2. **成形片\***（未使用成形片/ Palodent豆瓣成形片/V3成形片/其他），**楔子\***（未使用楔子/木楔/ Palodent V3楔子/其他）。

**3. 处理剂清洁窝洞，彻底冲洗，吹干。**

**4. 干燥隔湿，使用玻璃离子充填龋洞并涂上凡士林。**

**5.** **修形，调合，涂布凡士林。**

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| **ART修复：**  **1. 11牙，**显微镜下（如该项为“否”，则不显示该项）**，**高速牙钻法**去龋，以龋蚀显示剂指示，继续去净龋坏，**唇面,合面**制备洞形，深度：**4mm**。**  **2. 干燥，隔湿，使用**Palodent豆瓣成形片（如果是“未使用成形片”，则不显示）**，使用**木楔。  **3. 处理剂清洁窝洞，彻底冲洗，吹干。**  **4. 干燥隔湿，使用玻璃离子充填龋洞并涂上凡士林。**  **5. 修形，调合，涂布凡士林。** |

* 1. 预防性充填

1. **是否使用显微镜\***（否/显微镜下），**去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典/其它），**制备洞形位置\***（多选项，以英文逗号隔开，唇面/颊面/腭面/近中面/远中面/合面/根面），**制备洞形深度\***（输入项，单位为mm）。

2. **成形片\***（未使用成形片/ Palodent豆瓣成形片/V3成形片/其他），**楔子\***（未使用楔子/木楔/ Palodent V3楔子/其他）。

3. **比色板类型\***（Vita比色板/Chromascop比色板/Vitapan 3D-Master比色板/其它），**牙色\***（B1/A1/A2/D2/B2/C1/C2/D4/D3/A3/B3/A3.5/B4/C3/A4/C4/其它）。

4. **窝洞消毒\***（75%乙醇/氯己定/25%麝香草酚乙醇溶液/樟脑酚/其它），**垫底**（无/Dycal垫底/光固化氢氧化钙垫底/光固化玻璃离子垫底/流体树脂垫底/氧化锌丁香油+磷酸锌垫底/其它）。

5. **酸蚀，彻底冲洗，吹干。**

6.**涂布时间\***（<5s/5s-10s/10s-15s/15s-20s/>20s），**光照时间\***（5s/10s/15s/20s/25s/30s/40s），**酸蚀粘接系统类型\***（全酸蚀粘接系统/自酸蚀粘接系统），**全酸蚀粘接系统**（Scotchbond Multi-purpose(3M ESPE)/ All-Bond2(Bisco)/Amalgambond(Parkell)/Gluma Comfort Bond(Hereaus Kulzer)/ Adper Single Bond Plus(3M ESPE)/Prime&Bond NT(Dentsply)/其它），**自酸蚀粘接系统**（Optibond Solo Plus SE(Kerr)/Adhese(Vivadent)/Clearfil SE Bond(Kuraray)/XENO Ⅲ(Dentsply)/Adper PromptL-Pop(3M ESPE)/iBOND SelfEtch(Hereaus Kulzer)/G-Bond(GC)/XENOIV(Dentsply)/其它）。

7.**树脂\***（3M/Kerr/可乐丽/Kuraray/幻彩/其它），**树脂颜色\***（B1/A1/A2/D2/B2/C1/C2/D4/D3/A3/B3/A3.5/B4/C3/A4/C4/其它）。

8. **修型工具\***（蜡刀修型/瓷粉充填器修型/其它），**光固化灯\***（普通卤光灯/速效卤光灯/LED灯/离子弧光灯/氩激光灯/其它），**光固化灯光照时间\***（5s/10s/15s/20s/25s/30s/40s）。

9. **打磨抛光工具\***（金刚砂针/彩虹抛光系统/其它）。

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| **ART修复：**  **1. 11牙，**显微镜下（如该项为“否”，则不显示该项）**，**高速牙钻法**去龋，以龋蚀显示剂指示，继续去净龋坏，**唇面,合面**制备洞形，深度：**4mm**。**  **2. 干燥，隔湿，使用**Palodent豆瓣成形片（如果是“未使用成形片”，则不显示）**，使用**木楔。  **3.** Vita比色板**比色，选择牙色**B1。  **4.** 75%乙醇窝洞消毒，Dycal垫底（如果选择为“无”，则不显示）**。**  **5.** **酸蚀，彻底冲洗，吹干。**  **6. 涂布粘接剂：**全酸蚀粘接系统：Scotchbond Multi-purpose(3M ESPE)（全酸蚀粘接系统/自酸蚀粘接系统只显示一种类型，由酸蚀粘接系统类型确定）**，涂布**<5s**，吹干**5s**，光照**5s**。**  **7. 树脂：**3M**，颜色**：B1。  **8. 修型：**蜡刀修型**，**普通卤光灯**光照**5s**，**金刚砂针**调合打磨抛光。** |

* 1. 玻璃离子过渡性修复

1. **牙位，麻醉药物\***（无/阿替卡因/利多卡因/其它），**局部麻醉方法\***（无/阻滞麻醉/浸润麻醉），**使用橡皮障\***（是/否）。

2. **是否使用显微镜\***（否/显微镜下），**去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典/其它），**制备洞形位置\***（多选项，以英文逗号隔开，唇面/颊面/腭面/近中面/远中面/合面/根面），**制备洞形深度\***（输入项，单位为mm）。

3. **成形片\***（未使用成形片/ Palodent豆瓣成形片/V3成形片/其他），**楔子\***（未使用楔子/木楔/ Palodent V3楔子/其他）。

4. **窝洞消毒**（75%乙醇/25%麝香草酚乙醇溶液/樟脑酚/洗必泰/无窝洞消毒），**间接盖髓**（无/自凝氢氧化钙制剂/光敏氢氧化钙制剂）。

5. **玻璃离子充填**（Fuji Cem GC /Fuji Plus GC/FujiI GC）

6. **修型，调合，涂凡士林。**

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| 玻璃离子过渡性修复**：**  **1.11牙，使用阿替卡因麻醉**（如该项为“无”，则不显示该项）**，采用阻滞麻醉**（如该项为“无”，则不显示该项）**，使用橡皮障**（如该项为“否”，则不显示该项）  **2.** 显微镜下（如该项为“否”，则不显示该项）**，**高速牙钻法**去龋，以龋蚀显示剂指示，继续去净龋坏，**唇面,合面**制备洞形，深度：**4mm**。**  **3. 干燥，隔湿，使用**Palodent豆瓣成形片（如果是“未使用成形片”，则不显示）**，使用**木楔。  **4.75%乙醇窝洞消毒，光敏氢氧化钙制剂**（如该项为“否”，则不显示该项）。  **5.** Fuji Cem GC**玻璃离子充填。**  **6.修型，调合，涂凡士林。** |

* 1. 釉质成型术

1.**牙位**，**是否使用显微镜\***（否/显微镜下），**去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典/其它），磨除窝沟周边1mm不规则釉质突起，用细粒度金刚砂车针以窝沟为中心扩大开口，向周边和深部扩展约0.5mm,使窝沟呈浅碟形，避免在窝沟口形成锐边。

2．**低速手机**（锥形小毛刷/橡皮杯）蘸取适量牙膏于牙面，来回刷洗无龋牙面及窝沟1min，彻底冲洗清洁。

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| 釉质成型术  **1．11牙，**显微镜下（如该项为“否”，则不显示该项）**，**高速牙钻法**去龋，磨除窝沟周边1mm不规则釉质突起，用细粒度金刚砂车针以窝沟为中心扩大开口，向周边和深部扩展约0.5mm,使窝沟呈浅碟形，避免在窝沟口形成锐边。**  2．**低速手机装上**锥形小毛刷**蘸取适量牙膏于牙面，来回刷洗无龋牙面及窝沟1min，彻底冲洗清洁。** |

* 1. 微打磨术

**1. 牙位，低速手机**（锥形小毛刷/橡皮杯）蘸取适量牙膏于牙面，来回刷洗无龋牙面及窝沟1min，彻底冲洗清洁。

**2**. 涂抹约 2 ～ 3 mm 厚的磨膏层于牙面，**低速手机**（锥形小毛刷/橡皮杯）蘸取6.6% 盐酸及碳化硅微粒的水溶性磨砂膏剂来进行微打磨，轻微加力， 在牙齿表面打磨(2-3min,4-6min)。在每次微打磨之后，使用清水冲洗干净。

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| 微打磨术   1. **11牙，低速手机装上**锥形小毛刷**蘸取适量牙膏于牙面，来回刷洗无龋牙面及窝沟1min，彻底冲洗清洁。** 2. **涂抹约 2 ～ 3 mm 厚的磨膏层于牙面，低速手机装上**锥形小毛刷**蘸取6.6% 盐酸及碳化硅微粒的水溶性磨砂膏剂来进行微打磨，轻微加力， 在牙齿表面打磨(2-3min,4-6min)。在每次微打磨之后，使用清水冲洗干净。** |

1. 前牙美容修复
   1. 前牙无创美容修复

1. **牙位，**使用**麻醉药物**（无/阿替卡因/利多卡因/其它），**局部麻醉**（阻滞、浸润麻醉/无）， (是/否)**使用开口器**, (是/否)**使用咬合块**，**使用渗透树脂套装**（ICON/其他）。

2.（是/否）行**微研磨**：（无/橡皮障/光固化树脂牙龈保护剂）保护**牙龈**，**低速手机**（无/抛光杯/其他），**微研磨剂**（无/皓齿 Opalustre/其他）打磨，冲洗，吹干，涂布**氟保护剂**（无/多乐氟/其他）。 酸蚀剂**酸蚀**病变区域及周围牙体组织**时间**（1/2/3/其他min），涂布**干燥剂次数**（1/2/3/其他）次。涂布渗透树脂，**光固化时间**（5s、10s、15s、20s、25s、30s、40s）。

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| 前牙无创美容修复**：**  **1.11牙，使用阿替卡因麻醉**（如该项为“无”，则不显示该项）**，采用阻滞麻醉**（如该项为“无”，则不显示该项）**，使用开口器**（如该项为“否”，则不显示该项）**,使用咬合块**（如该项为“否”，则不显示该项）**，使用渗透树脂套装ICON。**  **2.行微研磨**（如该项为“无”，则不显示该项）：光固化树脂牙龈保护剂**保护牙龈**（如该项为“无”，则不显示该项），**低速手机装上**抛光杯（如该项为“无”，则不显示该项），**微研磨剂**皓齿 Opalustre**打磨**（如该项为“无”，则不显示该项），**冲洗，吹干，涂布氟保护剂**多乐氟（如该项为“无”，则不显示该项）。 **酸蚀剂酸蚀病变区域及周围牙体组织时间**1 min），**涂布干燥剂次数**1次。**涂布渗透树脂，光固化时间**5s。 |

* 1. 前牙微创复合树脂分层修复

1. **牙位，麻醉药物\***（阿替卡因/利多卡因/其它），**局部麻醉方法\***（阻滞麻醉/浸润麻醉），（是/否）**使用橡皮障\***。

2. **是否使用显微镜\***（否/显微镜下），**去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典/其它），**制备洞形位置\***（多选项，以英文逗号隔开，唇面/颊面/腭面/近中面/远中面/合面/根面），**制备洞形深度\***（输入项，单位为mm）。

3. **成形片\***（未使用成形片/ Palodent豆瓣成形片/V3成形片/其他），**楔子\***（未使用楔子/木楔/ Palodent V3楔子/其他）。

4. **比色板类型\***（Vita比色板/Chromascop比色板/Vitapan 3D-Master比色板/其它），**牙色\***（B1/A1/A2/D2/B2/C1/C2/D4/D3/A3/B3/A3.5/B4/C3/A4/C4/其它）。

5. **窝洞消毒\***（75%乙醇/氯己定/25%麝香草酚乙醇溶液/樟脑酚/其它），**垫底**（无/Dycal垫底/光固化氢氧化钙垫底/光固化玻璃离子垫底/流体树脂垫底/氧化锌丁香油+磷酸锌垫底/其它）。

6.**涂布时间\***（<5s/5s-10s/10s-15s/15s-20s/>20s），**光照时间\***（5s/10s/15s/20s/25s/30s/40s），**酸蚀粘接系统类型\***（全酸蚀粘接系统/自酸蚀粘接系统），**全酸蚀粘接系统**（Scotchbond Multi-purpose(3M ESPE)/ All-Bond2(Bisco)/Amalgambond(Parkell)/Gluma Comfort Bond(Hereaus Kulzer)/ Adper Single Bond Plus(3M ESPE)/Prime&Bond NT(Dentsply)/其它），**自酸蚀粘接系统**（Optibond Solo Plus SE(Kerr)/Adhese(Vivadent)/Clearfil SE Bond(Kuraray)/XENO Ⅲ(Dentsply)/Adper PromptL-Pop(3M ESPE)/iBOND SelfEtch(Hereaus Kulzer)/G-Bond(GC)/XENOIV(Dentsply)/其它）。

7. **树脂\***（3M/Kerr/可乐丽/Kuraray/幻彩/其它），**树脂颜色\***（B1/A1/A2/D2/B2/C1/C2/D4/D3/A3/B3/A3.5/B4/C3/A4/C4/其它）

8. **修型工具\***（蜡刀修型/瓷粉充填器修型/其它），**光固化灯\***（普通卤光灯/速效卤光灯/LED灯/离子弧光灯/氩激光灯/其它），**光固化灯光照时间\***（5s/10s/15s/20s/25s/30s/40s）。

9. **打磨抛光工具\***（金刚砂针/彩虹抛光系统/其它）。

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| 前牙微创复合树脂分层修复  **1.11牙，用阿替卡因麻醉**（如该项为“无”，则不显示该项）**，采用阻滞麻醉**（如该项为“无”，则不显示该项）**，使用橡皮障**（如该项为“否”，则不显示该项）  **2.** 显微镜下（如该项为“否”，则不显示该项）**，**高速牙钻法**去龋，以龋蚀显示剂指示，继续去净龋坏，**唇面,合面**制备洞形，深度：**4mm**。**  **3. 干燥，隔湿，使用**Palodent豆瓣成形片（如果是“未使用成形片”，则不显示）**，使用**木楔。  **4.** Vita比色板**比色，选择牙色**B1。  **5.** 75%乙醇窝洞消毒，Dycal垫底（如果选择为“无”，则不显示）**。**  **6. 涂布粘接剂：**全酸蚀粘接系统：Scotchbond Multi-purpose(3M ESPE)（全酸蚀粘接系统/自酸蚀粘接系统只显示一种类型，由酸蚀粘接系统类型确定）**，涂布**<5s**，吹干**5s**，光照**5s**。**  **7. 树脂：**3M**，颜色**：B1。  **8. 修型：**蜡刀修型**，**普通卤光灯**光照**5s**，**金刚砂针**调合打磨抛光。** |

* 1. 前牙微创CAD/CAM瓷贴面修复

同之前的贴面修复

**1.“****是否使用橡皮障\***（小棉球/细毛刷）”改为“（是/否**）使用橡皮障”**

2. **去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典）

4. **“取模材料\***（藻酸盐/硅橡胶/琼脂）”改为“数字化扫描取模”

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| **牙树脂直接充填修复：**  **1. 13牙**（此处牙位为口腔检查的牙位，如未设置，段落1的末尾提示“（当前病历还未设置牙位，请到口腔检查处设置病人相应牙位）”）**使用**阿替卡因**，**局部阻滞**麻醉，**使用橡皮障**。**  **2.** 显微镜下（如该项为“否”，则不显示该项）**，**高速牙钻法**去龋，以龋蚀显示剂指示，继续去净龋坏，**唇面,合面**制备洞形，深度：**4mm**。**  **3.** Vita比色板**比色，选择牙色**B1。  **4. 数字化扫描取模**  **5.** 75%乙醇窝洞消毒，Dycal垫底（此项选“无“则不显示）**。**  **6. 涂布粘接剂：**全酸蚀粘接系统：Scotchbond Multi-purpose(3M ESPE)（全酸蚀粘接系统/自酸蚀粘接系统只显示一种类型，由酸蚀粘接系统类型确定）**，涂布**<5s**，吹干**5s**，光照**5s**。**  **7. 放置贴面。**  **8.** 金刚砂针**调合打磨抛光。** |

1. 后牙嵌体修复

* 后牙嵌体修复类型：复合树脂嵌体，CAD/CAM瓷嵌体修复

1. **牙位，麻醉药物\***（阿替卡因/利多卡因/其它），**局部麻醉方法\***（阻滞麻醉/浸润麻醉），（是/否）**使用橡皮障\***。

2. **是否使用显微镜\***（否/显微镜下），**去龋方式\***（高速牙钻法/空气喷砂法/Carisolv化学去龋/超声去龋/激光去龋/手用器械伢典/其它），**制备洞形位置\***（多选项，以英文逗号隔开，唇面/颊面/腭面/近中面/远中面/合面/根面），**制备洞形深度\***（输入项，单位为mm）。**成形片\***（未使用成形片/ Palodent豆瓣成形片/V3成形片/其他），**楔子\***（未使用楔子/木楔/ Palodent V3楔子/其他）。**比色板类型\***（Vita比色板/Chromascop比色板/Vitapan 3D-Master比色板/其它），**牙色\***（B1/A1/A2/D2/B2/C1/C2/D4/D3/A3/B3/A3.5/B4/C3/A4/C4/其它）。**窝洞消毒\***（75%乙醇/氯己定/25%麝香草酚乙醇溶液/樟脑酚/其它），**垫底**（无/Dycal垫底/光固化氢氧化钙垫底/光固化玻璃离子垫底/流体树脂垫底/氧化锌丁香油+磷酸锌垫底/其它）。**涂布时间\***（<5s/5s-10s/10s-15s/15s-20s/>20s），**光照时间\***（5s/10s/15s/20s/25s/30s/40s），**酸蚀粘接系统类型\***（全酸蚀粘接系统/自酸蚀粘接系统），**全酸蚀粘接系统**（Scotchbond Multi-purpose(3M ESPE)/ All-Bond2(Bisco)/Amalgambond(Parkell)/Gluma Comfort Bond(Hereaus Kulzer)/ Adper Single Bond Plus(3M ESPE)/Prime&Bond NT(Dentsply)/其它），**自酸蚀粘接系统**（Optibond Solo Plus SE(Kerr)/Adhese(Vivadent)/Clearfil SE Bond(Kuraray)/XENO Ⅲ(Dentsply)/Adper PromptL-Pop(3M ESPE)/iBOND SelfEtch(Hereaus Kulzer)/G-Bond(GC)/XENOIV(Dentsply)/其它）。**树脂\***（3M/Kerr/可乐丽/Kuraray/幻彩/其它），**树脂颜色\***（B1/A1/A2/D2/B2/C1/C2/D4/D3/A3/B3/A3.5/B4/C3/A4/C4/其它），**修型工具\***（蜡刀修型/瓷粉充填器修型/其它），**光固化灯\***（普通卤光灯/速效卤光灯/LED灯/离子弧光灯/氩激光灯/其它），**光固化灯光照时间\***（5s/10s/15s/20s/25s/30s/40s）。

3.牙体预备：**高速手机使用钻针**(序列编号TF/TR/TC/RS/EX/CR/CD/SF/SO/SR/WR/BR/BC/DI/其他编号）

4．取工作模：**排龈**（无/排龈线型号0/00/000/其他），（藻酸盐/琼脂/硅橡胶/聚醚橡胶/数字化扫描）**取模**。

5．制作临时修复体，临时修复体粘接，**粘接剂**（磷酸锌/磷酸锌丁香油/其他）

6 .复诊，去除临时修复体，试戴，调改接触点，检查有无翘动，固位好，边缘密合，**氢氟酸**（登士柏/3M/松风/其他）**酸蚀修复体时间**（25s/30s/40s/50s/60s/其他），冲洗、干燥，涂布硅烷偶联剂，**磷酸酸蚀牙面时间**（25s/30s/40s/50s/60s/其他），冲洗，干燥，涂布**粘接剂品牌**（登士柏/3M/松风/其他品牌）涂布**粘接剂成分**（羧酸锌水门汀/树脂加强型玻璃离子/3M Unicem树脂粘接剂/GC FujiCEM树脂粘接剂/帕娜比亚树脂粘接剂/丁香油水门汀/GC暂时粘接剂/GC玻璃离子/其他），修复体就位，临时**光照时间**（2s/3s/4s/5s/6s/其他），去除多余粘接剂，调合，抛光。

|  |
| --- |
| **描述示例** |
| **后牙嵌体修复类型：复合树脂嵌体，CAD/CAM瓷嵌体修复：**  **1. 13牙**（此处牙位为口腔检查的牙位，如未设置，段落1的末尾提示“（当前病历还未设置牙位，请到口腔检查处设置病人相应牙位）”）**使用**阿替卡因**，**局部阻滞**麻醉，**使用橡皮障**。**  **2.** 显微镜下（如该项为“否”，则不显示该项）**，**高速牙钻法**去龋，以龋蚀显示剂指示，继续去净龋坏，**唇面,合面**制备洞形，深度：**4mm**。**Vita比色板**比色，选择牙色**B1。75%乙醇窝洞消毒，Dycal垫底（此项选“无“则不显示）**。涂布粘接剂：**全酸蚀粘接系统：Scotchbond Multi-purpose(3M ESPE)（全酸蚀粘接系统/自酸蚀粘接系统只显示一种类型，由酸蚀粘接系统类型确定）**，涂布**<5s**，吹干**5s**，光照**5s**。**  **3.牙体预备：高速手机使用钻针**TF。  **4**．**取工作模：使用**00号线**排龈**（如该项为“无”，则不显示该项），藻酸盐**取模**。  **5．制作临时修复体，临时修复体粘接，粘接剂为磷酸锌。**  **6** .**复诊，去除临时修复体，试戴，调改接触点，检查有无翘动，固位好，边缘密合，**登士柏**氢氟酸酸蚀修复体**25s，**冲洗、干燥，涂布硅烷偶联剂，磷酸酸蚀牙面**25s**，冲洗，干燥，涂布登士柏粘接剂**羧酸锌水门汀**，修复体就位，临时光照**2s**，去除多余粘接剂，调合，抛光**。  **8. 金刚砂针调合打磨抛光。** |

1. 其它
2. 删除现有的“嵌体修复”和“贴面修复”
3. 当用户错选一项，但该项又不是必选项，没有提供“无”的选择项

二、风险评估

风险评估

之前的风险评估由于没有评估等级，替换成下面的风险评估方案，评估方法和USPHS类似。评估结果为:低风险，中风险或者高风险

低风险：所有选项均勾选的低风险

中风险：勾选了低风险和中风险

高风险：有一项（或更多）勾选了高风险

龋病风险评估表（＞6岁）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 低风险 | 中风险 | 高风险 |
| 促进因素 | | 勾选以下选项 | | |
| 1 | 氟保护（饮水，氟制剂，专业涂氟，含氟牙膏） | 是 | 否 |  |
| 2 | 含糖食物或饮料（果汁，含碳或不含碳的软饮料，功能饮料，糖浆） | 只在饭点食用 |  | 经常食用或持续食用 |
| 3 | 母亲，照料者和/或兄弟姐妹（仅对6-14岁患者）的患龋经历 | 近2年内患龋 | 7-23个月内患龋 | 近6个月内患龋 |
| 4 | 建立患者档案，定期接受检查 | 是 | 否 |  |
| 一般健康情况 | |  |  |  |
| 1 | 特殊医疗看护（发育性、身体、心理残疾以至于不能得到足够的口腔健康维护） | 否 | 是（14岁以上） | 是（6-14岁） |
| 2 | 放疗 | 否 |  | 是 |
| 3 | 饮食紊乱 | 否 | 是 |  |
| 4 | 服用唾液量减少的药物 | 否 | 是 |  |
| 5 | 酗酒，药物成瘾 | 否 | 是 |  |
| 临床检查 | |  |  |  |
| 1 | 成洞或未成洞（早期龋）的龋损或充填（肉眼可见或X线片可见） | 近3年内无龋损或充填 | 近3年内1-2个新发龋损 | 近3年内新发龋损多余3处 |
| 2 | 在过去的3年内因龋缺失牙 | 无 |  | 有 |
| 3 | 软垢 | 无 | 有 |  |
| 4 | 特殊的牙体形态（影响口腔卫生） | 无 | 有 |  |
| 5 | 邻面龋（1或更多） | 无 | 有 |  |
| 6 | 牙根暴露 | 无 | 有 |  |
| 7 | 充填有悬突，边缘微渗漏；食物嵌塞 | 无 | 有 |  |
| 8 | 矫治器、义齿（固定或可摘） | 无 | 有 |  |
| 9 | 口干症 | 无 |  | 有 |

评估结果：低 中 高

1. USPHS评估

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 级别 | 标准 | 选项 |
| 颜色匹配 | A | 无明显颜色变化，色度、饱和度、透明度与邻牙匹配好 |  |
| B | 色度、饱和度、透明度变化，临床可接受 |
| C | 严重色度、饱和度、透明度变化， 临床不可接受 |
| 边缘适合性 | A | 探针和肉眼均不能检测出间隙，充填体与牙釉质良好接触，边缘无悬突、无着色。 |  |
| B | 探针探有间隙，肉眼可见超出或不足的边缘，边缘有轻微着色，但无牙体或基底材料暴露 |
| C | 探针探有间隙，有牙体或基底材料暴露，但无缺损或脱落 |
| D | 修复体折裂或部分脱落或全部脱落 |
| 解剖形态 | A | 修复体轮廓与牙体组织解剖形态和边缘连续 |  |
| B | 修复体充填稍多或稍欠，未暴露牙本质或基底 |
| C | 修复体缺损或缺失，牙本质或基地暴露 |
| 边缘着色 | A | 修复体与牙体之间边缘无着色 |  |
| B | 修复体与牙体之间有变色，但未沿洞缘向牙髓方向渗透 |
| C | 修复体与牙体之间有变色，沿洞缘向牙髓方向渗透 |
| 继发龋 | A | 无任何继发龋 |  |
| C | 可检测到修复体边缘周围继发龋 |

修改部分选项，删除大部分选项，